



# FlipChipシリーズ

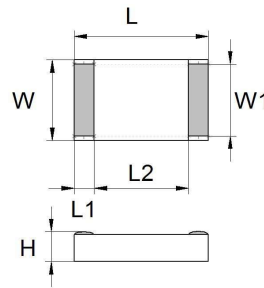
## FC白金センサ

はんだ付け又はボンディングによる自動実装用

### 特徴

- 優れた長期安定性
- 基板上で最小スペース
- 高速応答
- 低自己発熱
- 最適なコスト
- ボンディングバージョンが製作可能
- 要求に応じて特注センサーの製作可能

### 外観<sup>1)</sup>



<sup>1)</sup> 寸法参照

### 技術データ

使用温度範囲:	1FC	-50 °C ~ +150 °C
	2FC	-50 °C ~ +250 °C
	3FC	-50 °C ~ +250 °C
	5FC	-50 °C ~ +400 °C
	6FC	-50 °C ~ +600 °C
	公称抵抗値:*	100 Ω at 0 °C
500 Ω at 0 °C		
1000 Ω at 0 °C		
特性曲線:*	3850 ppm/K	
長期安定性:	< 0.04 % +130 °Cにて1000 h	
許容クラス(温度範囲に依存):*	ISTAG基準	
	IEC60751 F0.3	B
	IEC60751 F0.6	C



接続:*	1FC	錫コート, LMP鉛フリー, 96.5Sn/3Ag/0.5Cu) (リフローはんだ付け)
	2FC	錫コート, HMP 半田付けデポ, 5Sn/93.5Pb/1.5Ag (リフローはんだ 付け)
	3FC	金パッド (ボンディングパッド), 多種のタイプが製作可能
	5FC	強化薄膜白金パッド (半田付け可能パッド)
	6FC	厚膜白金パッド (溶接可能)
はんだ付け性: <sup>1)</sup>	235 °C ≤ 8 s (DIN IEC 68 T2-20, TaMeth. 1) - 1FC, 2FC, 5FC	
<small>1) はんだ付けプロセスは精度に影響を与えることがあります。</small>		
はんだ耐熱性:	260 °C 10 s (DIN IEC 68 T2-20, TaMeth. 1A) - 1FC, 2FC, 5FC	
推奨回路電流値: <sup>2)</sup>	1 mA at 100 Ω	
<small>2) 自己発熱を考慮する必要があります</small>		
	0.5 mA at 500 Ω	
	0.3 mA at 1000 Ω	
他の特殊仕様:*	裏面メタライズ 基板厚	
パッケージング:	< 100 pcs トレイにて	
	> 100 pcs テイピングリールにて	
	> 100 pcs ダイシング基板にて	

\* 利用可能な顧客固有の選択肢

ご注文情報 - 1FC (Contacts tin-coated (96.5Sn/3Ag/0.5Cu), LMP 鉛フリー)

サイズ	寸法 (L / L1 / L2 x W / W1 x Hin mm)	F0.3 (class B)
-----	------------------------------------	----------------

トレイにてパック (< 100 pcs)

公称抵抗値: 100 Ω at 0 °C

0603 (±0.2)	1.5 / 0.25 / 0.9 x 0.75 / 0.7 x 0.45 (±0.15)	P0K1.0603.1FC.B
注文番号		310.00655
0805 (±0.2)	1.9 / 0.25 / 1.4 x 1.15 / 1.1 x 0.45 (±0.15)	P0K1.0805.1FC.B
注文番号		010.02586

公称抵抗値: 500 Ω at 0 °C

0805 (±0.2)	1.9 / 0.25 / 1.4 x 1.15 / 1.1 x 0.45 (±0.15)	P0K5.0805.1FC.B
注文番号		010.02705

公称抵抗値: 1000 Ω at 0 °C

0603 (±0.2)	1.5 / 0.25 / 0.9 x 0.75 / 0.7 x 0.45 (±0.15)	P1K0.0603.1FC.B
注文番号		310.00656
0805 (±0.2)	1.9 / 0.25 / 1.4 x 1.15 / 1.1 x 0.45 (±0.15)	P1K0.0805.1FC.B
注文番号		010.02557



サイズ 寸法(L / L1 / L2 x W / W1 x Hin mm) F0.3 (class B)



テイピングリール (> 100 pcs)



公称抵抗値: 500 Ω at 0 °C

0805 (±0.2)	1.9 / 0.25 / 1.4 x 1.15 / 1.1 x 0.45 (±0.15)	P0K5.0805.1FC.B.S
注文番号	センサ面下	010.02706



公称抵抗値: 1000 Ω at 0 °C

0805 (±0.2)	1.9 / 0.25 / 1.4 x 1.15 / 1.1 x 0.45 (±0.15)	P1K0.0805.1FC.B.S
注文番号	センサ面下	010.02558



ダイシング基板 (> 100 pcs)

公称抵抗値: 1000 Ω at 0 °C

0805 (±0.2)	1.9 / 0.25 / 1.4 x 1.15 / 1.1 x 0.45 (±0.15)	P1K0.0805.1FC.B.S
注文番号		010.02602

### ご注文情報 - 2FC (錫コートコンタクト, はんだ付けデポ, HMP, 5Sn/93.5Pb/1.5Ag)

ご要望により制作可能

### ご注文情報 - 3FC (金-パッド (ボンディングパッド), 多種のタイプが製作可能)

サイズ 寸法(L / L1 / L2 x W / W1 x Hin mm) F0.3 (class B)

トレイにてパック (< 100 pcs)

公称抵抗値: 100 Ω at 0 °C

0805 (±0.2)	1.9 / 0.25 / 1.4 x 1.15 / 1.1 x 0.4 (±0.15)	P0K1.0805.3FC.B
注文番号		310.00536

1206 (±0.2)	2.9 / 0.35 / 2.1 x 1.4 / 1.3 x 0.4 (±0.15)	P0K1.1206.3FC.B
注文番号		310.00818

公称抵抗値: 1000 Ω at 0 °C

0603 (±0.2)	1.5 / 0.25 / 0.9 x 0.75 / 0.7 x 0.4 (±0.15)	P1K0.0603.3FC.B.S
注文番号		310.00653

0805 (±0.2)	1.9 / 0.25 / 1.4 x 1.15 / 1.1 x 0.4 (±0.15)	P1K0.0805.3FC.B
注文番号		010.02749

161	1.6 x 1.2 x 0.25 (±0.15)	P1K0.161.3FC.B
注文番号		010.01863



サイズ 寸法(L / L1 / L2 x W / W1 x Hin mm)

F0.3 (class B)

ダイシング基板 (> 100 pcs)

公称抵抗値: 100 Ω at 0 °C

0805 1.9 / 0.25 / 1.4 x 1.15 / 1.1 x 0.4 (±0.15)

P0K1.0805.3FC.B.S

注文番号

010.02717

### ご注文情報 - 5FC (強化薄膜パッド (半田付け可能パッド))

ご要望により制作可能

### ご注文情報 - 6FC (厚膜白金パッド (溶接可能))

サイズ 寸法(L / L1 / L2 x W / W1 x Hin mm)

F0.3 (class B)

公称抵抗値: 1000 Ω at 0 °C

0805 2.0 / 0.525 / 0.8 x 1.2 / 0.95 x 0.45 (±0.15)

P1K0.0805.6FC.B.S

310.01443

161 1.6 x 1.2 x 0.25 (±0.15)

P1K0.161.6FC.B

注文番号

010.00626

### 参考資料

和文資料名:

アプリケーションノート:

ATP\_J



# ご注文情報

## FC白金センサ

### 二次参照

材質

P = Platinum

TCR

Pt 3850 ppm/K

Resistance in  $\Omega$  at 0 °C

Size in mm

Operating temperature range

1 = -50 °C to +150 °C	5 = -50 °C to +400 °C
2 = -50 °C to +250 °C	6 = -50 °C to +600 °C
3 = -50 °C to +250 °C	

Connection

(1)FC = tin-coated, LMP lead-free, 6.5Sn/3Ag/0.5Cu
(2)FC = tin-coated, soldering depot, HMP, 5Sn/93.5Pb/1.5Ag
(3)FC = Au-Pads (bonding pads), various types available
(5)FC = reinforced thin-film Pt-pads
(6)FC = thick-film Pt-pads

Tolerance class

B = IEC60751 F0.3	K = customer-specific
C = IEC60751 F0.6	

Special

S = special	M = metallized backside
-------------	-------------------------

P 0K1.0805. 2 FC. B. S



オージー株式会社 OGG Co., Ltd. 〒 630-0247, 奈良県生駒市光陽台171  
TEL: 0743-74-4640 Fax: 0742-90-1455 Email: infojp@ogg-co.jp Web: www.ist-ag-japan.com

All mechanical dimensions are valid at 25 °C ambient temperature, if not differently indicated • All data except the mechanical dimensions only have information purposes and are not to be understood as assured characteristics • Technical changes without previous announcement as well as mistakes reserved • The information on this data sheet was examined carefully and will be accepted as correct; No liability in case of mistakes • Load with extreme values during a longer period can affect the reliability • The material contained herein may not be reproduced, adapted, merged, translated, stored, or used without the prior written consent of the copyright owner • Typing errors and mistakes reserved • Product specifications are subject to change without notice • All rights reserved